



金属烧结刀片

金属烧结刀的磨损速度比树脂刀片慢，但比镍刀快，最适合在BGA、软性氧化铝、碳化钛、低温共烧陶瓷（LTCC）、铁氧体等切割应用中保持封装的形状和尺寸。

刀片厚度: 80 – 1500µm

金刚石颗粒度: 2 – 70 µm

锯齿状:

金属烧结刀片可以提供锯齿状以及各种边缘形状。



金刚石颗粒度 (µm)	产品	材料	粘合剂种类
45 至 55	BGA, LGA (胶带和无胶带安装方法)	FR4, 塑料和注塑	C2/R5 MT1/MT2/MS08
30 至 50	QFN (半蚀刻)	铜引线框架 + 封装	Q7/C1
35 至 45	无源和有源设备。通信模块	低温共烧陶瓷	P1/P9
35 至 45	SAW器件, RF封装	高温共烧陶瓷	P1
13 至 25	摄像头模块	玻璃/红外玻璃	P1/P5 M06
25 至 45	陶瓷封装	氧化铝	P5/P9 MS06/MS07

金属烧结刀片物料号描述

厚度公差*	边缘形状**	外径	内径	颗粒尺寸** (µm)	厚度* M=mm, I=tenths
2 = ±.0001" 3 = ±.0002" 4 = ±.0005" B = ±.0003"	0 = 标准 N = 非标准 锯齿状 A = x16 插槽 (for 2" 刀片) A = x60 插槽 (for 4" 刀片) B = x32 插槽 (for 2" 刀片)	2 = 4.8" 3 = 4.7" 4 = 4.6" 5 = 4.5" 6 = 4.4" 7 = 4.3" 8 = 4.256" 9 = 4.0" A = 3.0" B = 2.5" C = 2.25" D = 2.188" E = 2.0" F = 58mm H = 77mm I = 60mm K = 54mm L = 82mm M = 56mm N = 75mm P = 52mm S = 2.75" T = 78mm Z = 74mm W = 79mm	1 = 3.5" 2 = 88.82mm 6 = 40mm	0A = 3-6 02 = 1-2 03 = 2-4 07 = 6-8 10 = 10 70 = 70	(050) = 50 (200) = 200 (600) = 600
示例型号	4S0 3 0 - 5 2 10 - 120-I XX	产品系列			
±.0002"	标准	4.5" 外径	88.82 mm	10 µm 颗粒	12 mil 厚度

* 取决于金刚石颗粒度 ** 取决于刀片厚度和金刚石颗粒度
其他厚度选项、直径、边缘几何形状和金刚石颗粒度可根据要求提供。